

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳盡說明，請參閱「業務－我們的戰略」。

[編纂]用途

假設[編纂]為每股股份[編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的中位數)，經扣除我們就[編纂]已付及應付的[編纂]及其他估計開支後，並假設[編纂]未獲行使，我們估計將收取[編纂][編纂]淨額約[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)。根據我們的戰略，我們擬將[編纂][編纂]按下述金額用於下述用途：

- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)預計將用於增強我們的研發和創新能力，包括：
 - (i) [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)將於未來五至十年用於挽留、擴大及加強我們的研發團隊。根據弗若斯特沙利文的資料，中國的BLDC電機主控及驅動芯片市場預計將從2024年的人民幣96億元增長至2028年的人民幣204億元，複合年增長率為20.9%，主要是受到汽車、工業領域以及人工智能應用需求預期增加的帶動。半導體行業乃人才密集型行業，自成立以來，我們已制定以「內部培訓、導師指導及項目學習」為核心的人才培養策略。截至2024年12月31日，我們已建立一支由198名成員組成的多層次研發人才團隊，佔我們員工總數的73.3%。因應對採用我們產品的下游應用的需求增長，於未來五至十年內，我們計劃吸引和挽留額外約180名(複合年增長率為6.7%至13.6%)具備數字芯片設計、模擬芯片設計、電機驅動架構算法、硬件及測試專業知識的研發人才，以及來自知名大學並擁有相關學位的人才，從而不斷提升我們在快速增長的汽車、工業領域及人工智能應用的研發能力；
 - (ii) [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)將用於投資研發基礎設施。具體而言，我們計劃購買(i)芯片可靠性測試設備，例如微光顯微鏡、參數曲線追蹤儀和超聲波掃描顯微鏡；(ii)實驗室設備，例如半導體參數測試設備、熱界面材料測試儀和芯片測試主機系統；(iii)電腦；及(iv)軟件；及

未來計劃及[編纂]用途

- (iii) [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)將用於購買研發材料，例如光掩模版、印刷電路板及電子元件。
- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)預計將用於進一步豐富我們的產品組合及擴展下游應用。我們的產品開發策略基於穩健的技術佈局及對下游應用的廣泛覆蓋。藉助我們的自主雙核架構及專業的電機驅動架構算法，我們將通過投資產品研究、產品測試以及與主要行業合作夥伴的戰略合作，不斷開發為各種下游應用量身定制的產品。
 - (i) [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)將用於提升我們在智能小家電及白色家電等消費市場的競爭力。具體而言，我們計劃在消費應用中多元化和升級我們的產品線，以吸引更多的領先品牌成為我們的終端客戶，這需要我們在以下方面承擔額外成本：(a)通過投資關鍵設備來支持我們的封裝測試供應商的產能提升，從而滿足終端客戶需求；及(b)招聘及挽留消費市場具有豐富經驗的約20名產品銷售和營銷人員，以拓展我們產品的下游應用；及
 - (ii) [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)將用於進一步拓展我們在汽車和機器人行業等新興應用領域的業務。我們計劃投資開發與升級我們於該等行業的技術優勢，以抓住新的市場機遇。我們預計將在以下方面承擔額外成本：(a)車規級產品資格；(b)通過投資關鍵設備來支持我們的封裝測試供應商的產能提升，從而滿足我們的終端客戶需求；及(c)招聘及挽留於該等新興市場具有豐富經驗的20名銷售及營銷人員，以拓展我們產品的下游應用，從而在競爭對手中獲得先發優勢。
- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)預計將用於擴展我們的海外銷售網絡及於海外市場推廣我們的產品。具體而言，我們計劃投資於(a)在新加坡、韓國、日本及歐洲等海外市場建立銷售和技術支持團隊；及(b)針對海外客戶參與的市場推廣舉措，例如(其中包括)推出宣傳活動、與當地經銷商合作以及參加展會和論壇，以進一步提升我們的品牌知名度。為我們的海外銷售及營銷團隊招聘具有行業見解的銷售及營銷人員，不僅可以擴大我們銷售網絡的地理覆蓋範圍，還可以吸引及發展更多參與我們產品相關下游應用(尤其是在汽車、工業領域、消費電子和機器人行業)的客戶。

未來計劃及[編纂]用途

- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)預計將用於戰略性投資及／或收購，以實現我們的長期增長策略。我們尋求全球半導體行業內的潛在投資及收購機會，並根據以下一般挑選標準選擇潛在目標：
 - (i) 目標的業務應與我們的業務展現協同效應或互補。我們計劃投資及／或收購半導體價值鏈中的公司，包括但不限於晶圓生產商、功率器件公司、IP供應商以及其他芯片設計或傳感器公司，以進一步提升我們的技術能力，確保產能，並改善我們的加工技術。具體而言，目標應：(a)擁有能補足我們自身的強大技術能力；或(b)能夠幫助我們擴展產品組合並加速滲透更多下游應用市場。晶圓製造是半導體價值鏈的關鍵環節。雖然我們將保持fabless模式，但我們可能尋求通過策略投資及／或收購晶圓製造商來加強供應鏈自主性以實現更緊密的合作，並確保與我們的產品創新具有更好的協同效應；及
 - (ii) 目標的管理團隊應具備半導體行業的知識及豐富的相關經驗。
- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)預計將用於營運資金及一般企業用途。

倘[編纂][編纂]淨額多於或少於預期(包括因(i)[編纂]設定高於或低於[編纂]範圍的中位數；或(ii)行使[編纂]的額外[編纂]淨額)，我們將按比例調整[編纂]淨額的分配以用作上述用途。

倘我們發展計劃的任何部分因政府政策變動等原因導致我們任何項目的開發不可行或發生不可抗力事件等原因而未能按計劃進行，我們將審慎評估情況，並可能重新分配[編纂][編纂]淨額。

倘[編纂][編纂]淨額並未即時用作上述用途或我們無法按預期實施計劃的任何部分，以及在相關法律及法規准許的情況下，我們僅會將該[編纂]淨額存入持牌商業銀行及／或其他獲授權金融機構(定義見證券及期貨條例或其他司法權區的適用法律及法規)的短期計息賬戶。於此情況下，我們將遵守上市規則項下的適當披露規定。